Second Circular

Mate2014

20th Symposium on"Microjoining and Assembly Technology in Electronics"

第２０回「エレクトロニクスにおけるマイクロ接合・実装技術」シンポジウム

日　時：　平成２６年２月４日（火），５日（水）

場　所：　パシフィコ横浜　会議センター（横浜市西区みなとみらい1丁目1-1）

主　催：　(社)スマートプロセス学会　エレクトロニクス生産科学部会
(社)溶接学会　マイクロ接合研究委員会

《新たな成長～戦略市場創造を支える実装技術》

日本のエレクトロニクス産業は、この20年間、高機能化、高信頼化、小型化、低コスト化の技術開発に支えられた新たな電子デバイス・部品を組み込んだ電子システム創成の下、日本の高度成長を牽引してきました。今後も日本が世界を先導し続けるには、生産技術を科学的に探求することはもちろんのこと、既存の学問領域、設計・生産技術などの領域を越えて、エレクトロニクスを取巻く科学技術、経営・生産システム、価値システム、などの広い範囲を取り込んだグローバルなオプティマイゼーションとそれに基づくシステムインテグレーションが不可欠になってきています。本シンポジウムは，これら生産技術に関する最新の研究・開発に関する研究者相互の情報交換の場をより広くかつ定期的に持ち，生産の科学と技術の進展を促すことを目的として企画開催されます。

共　催：　(社)エレクトロニクス実装学会
(社)化学工学会　エレクトロニクス部会
(社)日本機械学会　エレクトロニクス実装のプロセスと製品における信頼性評価と熱制御に関する研究分科会
(社)レーザ加工学会

協　賛：　映像情報メディア学会、応用物理学会、画像電子学会、軽金属学会、計測自動制御学会、高分子学会、資源・素材学会、システム制御情報学会、情報処理学会、精密工学会、電気化学会、電気学会、電気設備学会、電子情報通信学会、日本機械学会、日本金属学会、日本顕微鏡学会、日本材料学会、日本シミュレーション学会、日本接着学会、日本セラミックス協会、日本塑性加工学会、日本伝熱学会、日本非破壊検査協会、日本表面科学会、日本品質管理学会、日本複合材料学会、日本物理学会、日本分析化学会、日本溶接協会、表面技術協会、プラスチック成形加工学会　(一部依頼中を含む)

参加申込〆切：平成26年1月17日(金)

参加申込：下記シンポジウムURLより、期日までに参加登録を行って下さい。参加費のお支払いは銀行振込にてお願い致します。なお、振込期日までにお振込みが間に合わない場合は、当日現金にてお支払い願います。
【振込先】　三井住友銀行 千里中央支店 普通口座 0978673　口座名：Mate組織委員会
【振込期日】平成２６年２月２８日(金)
【URL】　http://sps-mste.jp/mate2014/src/

懇親会：　シンポジウム１日目に懇親会を開催します。シンポジウム参加申込時にお申し込みください。
(日　時) 平成26年2月4日（火）17:45～
(場　所) パシフィコ横浜 会議センター6階
「ベイブリッジカフェテリア」
(参加費) 5,000円

《参加費》

主催団体個人会員	：15,000円
大学・国公立研究機関	：15,000円
発表者	：15,000円
主催団体維持・賛助会員	：20,000円
共催団体会員	：20,000円
一　般	：30,000円
学　生	：　5,000円

Mate 2014 プログラム

2月4日（火）

時間	A会場	B会場
8:50	開会の挨拶　Mate2014組織委員会委員長　藤本 公三　（A会場）	
9:00 ～ 10:40	[A-1]　３Ｄ実装 座長：青柳　昌宏（(独)産業技術総合研究所） 1. VHF-CCPプラズマ源を用いたSiエッチバックプロセスのVia reveal応用 *森川 泰宏, 村山 貴英, 作石 敏幸, 鄒 弘綱(㈱アルバック) 2. （仮題）3D-IC層間材料のプレアプライ接合とその信頼性評価 *桐谷秀紀, 河瀬康弘, 池本慎, 杉山雅哉, 水谷文一(三菱化学), 山崎正典(三菱化学科学技術研究センター), 松本圭司, 森裕幸, 折井靖光(日本アイ・ビー・エム) 3. Injection Molded Solder技術を用いた微細はんだバンピングに対するはんだ材料特性の影響 *青木豊広, 鳥山和重, 森裕幸, 折井靖光(日本アイ・ビー・エム㈱) 4. 三次元LSIのためのAg-Sn系多層薄膜を用いた低温低圧接合ﾌﾟﾛｾｽに関する研究 *重本拓巳, 米田聖人, 金崎亮太, 佐藤了平, 岩田剛治(大阪大学) 5. 3次元ｼﾘｺﾝﾁｯﾌﾟ積層構造におけるｴﾚｸﾄﾛﾏｲｸﾞﾚｰｼｮﾝによる劣化への影響 *小原　さゆり, 乃万　裕一, 末岡　邦昭, 森　裕幸, 折井　靖光（日本アイ・ビー・エム㈱), 山田 文明(超先端電子技術開発機構(ASET))	[B-1]　ソルダペースト 座長：渡邉　裕彦（富士電機(株)） 30. 機能性樹脂強化ソルダペーストによるソルダリング過程についての観察 *安田清和(大阪大学) 31. 高鉛含有ソルダペースト代替え技術の実用化 *大熊章, 鈴木実(松尾ハンダ㈱) 32. 変位検出によるソルダペーストの新しいぬれ性試験方法 *西室　将, 平本　清(山陽精工㈱) 33. 高接合信頼性Pbフリークリームはんだ用エポキシ系フラックス *雁部竜也, 渡邉裕彦(富士電機), 小笠原毅, 山本睦之(ニホンハンダ), 岡本健次(富士電機) 34. スズ合金の金属結合状態と融点 *高原 渉(大阪大学)
10:40	休　憩	
10:50 ～ 12:50	[A-2]　低温実装 座長：高岡　英清（(株)村田製作所） 6. 【講演】原子拡散接合法を用いた室温接合技術 島津 武仁(東北大学) 7. Sn-Biはんだ継手の衝撃強度や接合界面に及ぼすレーザ照射条件の影響 *窪田　慎也, 西川　宏(大阪大学) 8. Sb, Zn添加Sn-Bi系はんだと無電解Ni/AuおよびNi/Pd/Au電極の接合特性に及ぼす時効の影響 *平田晃大, 荘司郁夫(群馬大学), 土田徹勇起, 大久保利一(凸版印刷㈱) 9. Cuピラー／Sn-Biはんだフリップチップ接合部電極構造の信頼性に及ぼす影響 *清水　浩三, 作山　誠樹, 酒井　泰治, 今泉　延弘(㈱富士通研究所), 村山啓, 相澤　光浩, 栗原　孝, 東　光敏(新光電気工業㈱) 10. Cuピラー／Sn-Biはんだフリップチップにおけるﾋﾞｽﾏｽ濃度のエレクトロマイグレーション現象への影響 *村山　啓, 栗原　孝, 相澤　光浩(新光電気工業㈱), 酒井　泰治, 今泉　延弘, 清水　浩三, 作山　誠樹(㈱富士通研究所), 東　光敏(新光電気工業㈱)	[B-2]　熱マネジメント 座長：柳浦　聡（(株)三菱電機） 35. 過渡熱測定による接合部の熱抵抗測定 *遠藤亮, 平野孝行, 高井良浩, 山根常幸(東レリサーチセンター) 36. 赤外線サーモグラフィを用いた微小部品の温度測定に関する検証 ～角度依存性及び空間分解能に関する考察～ *平沢浩一, 有賀善紀(KOA㈱), 国峯尚樹(KOA㈱), ㈱サーマルデザインラボ), 富村 寿夫(熊本大学) 37. 微小部品の熱電対による温度測定精度向上への提言　～集中熱抵抗を考慮した取り付けと、熱回路網法による誤差補正についての提案～ *平沢浩一, 有賀善紀(KOA㈱), 国峯尚樹(KOA㈱), ㈱サーマルデザインラボ), 富村 寿夫(熊本大学) 38. マイクロプロセッサパッケージにおける拡大熱抵抗の非定常挙動に関する考察 *西剛伺(日本AMD), 畠山友行, 中川慎二, 石塚勝(富山県立大学) 39. 平板型蒸発器を有するループヒートパイプの熱流体回路モデルの構築と検証 *尾形　晋, 助川　英次, 谷 元昭(㈱富士通研究所) 40. 3DICの放熱構造に向けたシリコンベーパーチャンバーの開発 *谷口　淳, 塩賀　健司, 水野　義博(富士通研究所)
12:50	昼食休憩	
13:50 ～ 16:00	＜プレナリーセッション＞　「新たな成長～戦略市場創造を支える実装技術」　座長：上西　啓介（大阪大学）　（A会場） 1. ヘルスケアとMEMS、求められる実装技術　貫井　晋(オムロン㈱　マイクロデバイス事業推進本部) 2. クルマ社会を変えるエレクトロニクス技術　～環境・安全・利便・快適の視点で見る～　新見 幸秀(㈱デンソー　電子基盤技術本部) 3. コグニティブ・コンピューティング時代を牽引するコア・テクノロジー　森本 典繁(日本アイ・ビー・エム㈱　東京基礎研究所)	
16:00 ～ 17:30	＜ポスターセッション＞、Coffee Break　（5階　フォワイエ） P-1　インジウムボールの表面化学処理による凝集制御 *川﨑浩由[1,2], 岡田弘史[1], 六本木貴弘[1], 相馬大輔[1], 馬渡佳秀[2], 山村方人[2], 鹿毛浩之[2], 荒木孝司[2], 柘植顕彦[2]　([1]千住金属工業㈱, [2]九州工業大学) P-2　インジウムボールの超音波照射による形状制御 川﨑浩由[1,2], *岡田弘史[1], 六本木貴弘[1], 相馬大輔[1], 村上直也[2], 横野照尚[2], 荒木孝司[2], 柘植顕彦[2]　([1]千住金属工業㈱, [2]九州工業大学) P-3　レーザ加熱したはんだバンプの接合信頼性への微細化の影響　*宇治野　真, 西川　宏(大阪大学) P-4　AlN/AlCu/AlNナノ積層膜の作製と電気・光学特性について　*小川倉一, 近藤匡俊(小川創造技術研究所), 安田政智, 相良れい子(㈱京都薄膜応用技術研究所) P-5　大気圧プラズマを用いた最新のアルミニウム合金の拡散接合技術　*尾ノ井　正裕(金属技研) P-6　金属塩生成接合法によるCu/Cu固相接合条件の緩和　*萩原尚基, 小山真司, 荘司郁夫(群馬大学) P-7　酢酸を用いた金属塩生成接合法によるAl合金/SUS304の固相接合条件の緩和　*松原広太, 小山真司, 荘司郁夫(群馬大学) P-8　マイクロ接合部強化のためのフェムト秒レーザピーニング技術の開発　*松山法央, 佐野智一, 廣瀬明夫(大阪大学) P-9　樹脂/樹脂および樹脂/金属界面の接着に関する評価　*泉 由貴子(東レリサーチセンター) P-10　様々なサイズ・形状の銀フィラーを混合した導電性接着剤の熱伝導性　*小島慎也, 西川宏(大阪大学) P-11　溶融Snとプラズマ窒化ステンレス鋼の界面反応　*服部真吾, 荘司郁夫(群馬大学), 桑原秀行(MPT) P-12　水蒸気・酸素雰囲気、金属酸化物共存下でのポリマー熱分解生成物と発生挙動評価　*美野　卓大, 大川　朋寛(㈱東レリサーチセンター) P-13　Sn-Ag-Cuはんだ合金の引張強度に及ぼす試験片サイズの影響　*岩崎真也, 山内啓(群馬高専) P-14　高電圧放電溶接法によるSEM用高輝度フィラメントの作製　*今野武志, 江頭満, 小林幹彦(物材機構) P-15　セラミックスの熱放射を利用した冷却技術の実証研究　西村威夫, *中田光城(西村陶業㈱) P-16　無電解Ni/Agめっきのはんだ接合性およびワイヤーボンディング性評価　*青木 智美, 工藤 喜美子, 田邉 靖博(奥野製薬工業㈱), 縄舟 秀美(甲南大学) P-17　表面粗化処理したアルミニウムとポリフェニレンサルファイドの直接接合　*齋藤　遼, 安田清和, 平田好則(大阪大学) P-18　Agナノ粒子焼結体の低サイクル疲労特性　*潮來真広, 苅谷義治(芝浦工大), 水村 宜司, 佐々木 幸司(ナミックス㈱) P-19　Agナノ粒子およびAg・Cu混合ナノ粒子ペーストのパワーデバイス接合性評価　*松林 良(新電元工業㈱) P-20　ラミネート工程におけるカール挙動に関する考察　*大西郷, 神田敏満, 金子智(リンテック㈱) P-21　スルーホールビア用銅めっき薄膜の低温クリープ　*矢島直幸, 苅谷義治(芝浦工大), 菊池俊一, 広島義之, 松井亜紀子(富士通アドバンストテクノロジ㈱), 清水浩(日立化成), 中村一彦(High Density Packaging User Group International) P-22　Bi少数個結晶体における双晶とすべりの協調変形　*田嶋 翔, 李 濱然, 苅谷 義治(芝浦工大), 渡邉 裕彦(富士電機㈱) P-23　WLCSPの落下衝撃時におけるﾎﾟﾘｲﾐﾄﾞ層の応力緩衝効果　*下田秀治, 苅谷義治, 坂巻一星(芝浦工大), 藤田 充, 安西信裕(旭化成ｲｰﾏﾃﾘｱﾙｽﾞ)	
17:45	懇　親　会　（6階 ベイブリッジカフェテリア）	

2月5日（水）			
時間	A会場	B会場	C会場
9:00 ～ 10:40	[A-3]　パワーデバイス（１） 座長：山口　敦史（(株)パナソニック） 11. パワーモジュールにおけるマイクロTIG溶接技術の開発 ＊日野泰成，吉松直樹，上田哲也，中島泰(三菱電機㈱) 12. 半導体パワーモジュール絶縁基板の部分放電現象観察と耐電圧向上課題 ＊早瀬悠二，山城啓輔，高野哲美，外薗洋昭(富士電機) 13. 超音波接合におけるインサート材が接合性に与える影響 ＊米田裕，菊池正雄，坂元創一，柳本辰則(三菱電機㈱)，茂永隆(メルコパワーデバイス㈱) 14. ﾊﾟﾜｰﾓｼﾞｭｰﾙのはんだ接合部の高信頼化に関する検討 ＊村松佑哉，中島泰，別芝範之(三菱電機㈱) 15. パワーモジュール適用のためのプレスフィット端子構造の開発 ＊江草 稔，村井 淳一，宮本 照雄，加柴良裕(三菱電機)，福本 信次，藤本公三(大阪大学)	[B-3]　接合信頼性（１） 座長：田辺　一彦（日本電気(株)） 41. 粘塑性・クリープ分離モデルを用いた鉛フリーはんだ接合部の熱疲労寿命評価 ＊林丈晴(東京高専)，海老原理徳(東京学芸大学)，渡邉裕彦，浅井竜彦(富士電機)，楊振華(東プレ) 42. Sn-Ag-Bi-In系はんだの高耐熱疲労特性に対する計算力学的アプローチ ＊岡崎亨，日根清裕(パナソニック㈱) 43. Sn-Ag-Cu合金における微小疲労き裂進展挙動 ＊小川賢介，苅谷義治（芝浦工大），大井秀哉，小林卓哉（㈱メカニカルデザイン） 44. Sn-Ag-Cu微小接合部における連続動的再結晶と低サイクル疲労損傷 ＊文倉智也，紺谷洋之，苅谷義治(芝浦工大) 45. 熱負荷によるはんだ接合部組織変化の振動疲労負荷試験における影響 ＊松嶋道也，松尾圭一郎，舟引喜八郎，福本信次，藤本公三(大阪大学)	[C-1]　基板パッケージ 座長：渡辺　裕之（イビデン(株)） 59. マルチチップパッケージを実現するチップ間接続技術の開発 ＊神吉剛司，池田淳也，岡野歩，須田章一，小林靖志，中田義弘，中村友二(㈱富士通研究所)，金田渉，六川昭雄(新光電気工業㈱) 60. パターンめっき法におけるAu-Sn合金の酸化メカニズムの解明 ＊中山俊弥，浮田康成，樋口和人，細美英一，村川篤(㈱東芝) 61. 銅のウエットエッチングにおける界面活性剤が与える影響 ＊久保田賢治(三菱マテリアル)，畑中亮英(元八戸高専)，関下明日香(八戸高専)，吉原佐知雄(宇都宮大学)，松本克才(八戸高専) 62. 液晶ポリマー用接着剤の開発 ＊板野 和幸，井上 堯大，松土 和彦，中屋敷哲千(㈱ADEKA)
10:40	休　憩		
10:50 ～ 12:50	[A-4]　パワーデバイス（２） 座長：鳥山　和重（日本アイ・ビー・エム(株)） 16. ﾌｨﾗｰ分散把握による界面熱抵抗定量化と熱伝導率予測 ＊荒尾修，新帯亮，杉浦昭夫(㈱デンソー) 17. ポッティング封止型パワー半導体パッケージの開発 ＊小川翔平，藤野純司，菊池正雄(三菱電機㈱) 18. パワー半導体用高温動作・高信頼性対応新規はんだ材料の開発 ＊齊藤　隆，西村芳孝，木戸和優，百瀬文彦，望月英司，高橋良和(富士電機) 19. 高温動作SiC素子実装のための金系はんだの融点制御技術 ＊高橋弘樹，村上善則[1]，加藤史樹[2]，渡辺衣世，佐藤伸二，安在岳志，谷澤秀和，樋山浩平[1]([1]FUPET，[2]産総研) 20. SiCﾊﾟﾜｰﾃﾞﾊﾞｲｽを想定したAlﾊﾞﾝﾌﾟのﾌﾘｯﾌﾟﾁｯﾌﾟ実装技術 ＊谷澤秀和[1,2]，樋山浩平[3,2]，渡辺衣世[2]，安在岳士[4,2]，高橋弘樹[5,2]，佐藤伸二[1,2]，村上善則[6,2]，佐藤弘[7,2] ([1]ｻﾝｹﾝ電気，[2]FUPET，[3]東芝，[4]ｶﾙｿﾆｯｸｶﾝｾｲ，[5]富士電機，[6]日産自動車，[7]産総研)	[B-4]　接合信頼性（２） 座長：赤松　俊也（(株)富士通研究所） 46. 【講演】本質を探る最新の分析・解析技術 長澤 佳克(㈱東レリサーチセンター) 47. 鉛フリーはんだの耐熱疲労特性に対する固溶元素の効果に関する研究(第2報) ＊日根清裕，酒谷茂昭，岡崎亨，森将人，古澤彰男(パナソニック㈱) 48. Sb粉末を添加したSn-3Ag-0.5Cuはんだの接合信頼性 ＊福田敦(大阪大学)，山田隆行，別芝範之(三菱電機㈱)，加柴良裕(大阪大学，三菱電機㈱) 49. Cu-Snはんだ/Cuリードフレーム界面に及ぼすNiの影響 -界面反応の熱力学- ＊前嶋貴士，池畑秀哲(豊田中央研究所)，照井賢一郎，坂本善次(デンソー) 50. ｴﾎﾟｷｼ系ﾌﾗｯｸｽによるﾎﾞｰﾙ接合部衝撃特性の向上効果 ＊石山旺欣，荘司郁夫(群馬大学)，雁部竜也，渡邉裕彦(富士電機㈱)	[C-2]　ＭＥＭＳ 座長：近藤　雄（オリンパス(株)） 63. 【講演】（仮題）健康を計るＭＥＭＳバイオセンサ・チップの開発 脇田 慎一(産業技術総合研究所) 64. 涙液中グルコースモニタリングのためのソフトコンタクトレンズ型バイオセンサの開発 ＊荒川貴博，三林浩二(東京医科歯科大学) 65. 心筋細胞のマイクロチップ内薬物応答顕微イメージング 山口佳則(大阪大学) 66. 接着剤併用Sn-Biはんだにおける接着剤硬化特性の適正化 ＊北村和大，伊達仁昭，八木友久，山岸康男(富士通クオリティ・ラボ㈱) 67. ガラス、フィルムの常温接合技術とその応用 松本　好家(ランテクニカルサービス㈱)
12:50	昼食休憩		
13:50 ～ 15:50	[A-5]　パワーデバイス（３） 座長：三治　真佐樹（(株)デンソー） 21. 共晶反応と表面微細形状を利用したｱﾙﾐﾆｳﾑﾀﾞｲﾚｸﾄ接合の基礎的検討（共晶反応と表面微細形状を利用したPbﾌﾘｰ-SiC高温実装技術（第一報）） ＊小椋 智，山本将貴，廣瀬明夫(大阪大学)，宮本健二，杉千花，中川成幸，上原義貴，南部俊和(日産自動車) 22. 共晶反応と表面微細形状を利用したｱﾙﾐﾆｳﾑﾀﾞｲﾚｸﾄ接合の半導体ﾁｯﾌﾟ実装への適用とその特性評価(共晶反応と表面微細形状を利用したPbﾌﾘｰ-SiC高温実装技術（第二報）） ＊宮本健二，杉 千花，中川成幸，上原義貴，南部 俊和(日産自動車㈱)，山本将貴，小椋 智，廣瀬明夫(大阪大学) 23. Cuナノ粒子接合のパワーサイクル信頼性 ＊久野敦輝，柳瀬匡史，田根篤，大澤文明，山田靖(大同大学)，石崎敏孝，佐藤敏一(㈱豊田中央研究所) 24. 酸化銀-酸化銅ペーストを用いた接合の継手特性評価 ＊藤本 智之，小椋 智，廣瀬 明夫(大阪大学) 25. 銀ナノ粒子を用いたSiCダイボンディング部の熱過渡解析による評価 ＊八坂慎一，三橋雅彦，田口勇，篠原俊朗(神奈川県産業技術センター)	[B-5]　樹脂実装 座長：八甫谷　明彦（(株)東芝） 51. 導電性接着剤のキュアプロセスにおける粘弾性特性と電気伝導特性変化の同時測定 ＊坂庭 慶昭，多田 泰徳，井上 雅博(群馬大学) 52. 導電性接着剤における導電性発現機構の影響因子に関する研究 ＊白木義彦，小日向茂(大阪大学)，井上雅博(群馬大学)，上西啓介(大阪大学) 53. ハイブリッド樹脂実装における導電路形成メカニズム ＊福本信次，山本悠斗，薮田康平，松嶋道也，藤本公三(大阪大学) 54. 耐疲労性向上のためのストレッチャブル配線用導電性ペーストのフィラー配合設計 ＊板橋 洋介，井上 雅博，多田 泰徳(群馬大学) 55. フリップチップ接合用アンダーフィル材の機械的特性に及ぼすカップリング剤の影響 ＊三ツ木寛尚，荘司郁夫，小山真司，北郷慎也（群馬大学）	[C-3]　マイクロ接合・新材料プロセス(1) 座長：安田　清和（大阪大学） 68. 摩擦発熱現象を利用した大型ﾎﾟｰﾗｽAlの作製 ＊圖子田幸佑，半谷禎彦(群馬大学)，桑水流理(福井大学)，吉川暢宏(東京大学) 69. 摩擦発熱プロセスを利用したオープンセル型多孔質金属の創製 ＊半谷禎彦，圖子田幸佑，石原綾乃(群馬大学)，藤井英俊，上路林太郎(大阪大学)，桑水流理(福井大学)，吉川暢宏(東京大学) 70. 微小な異種金属接合部を得るためのジュール熱溶接 ＊燈明泰成，渡邊彬仁，砂川拓也(東北大学) 71. マイクロ光造形法三次元プリンタを用いた誘電体デバイスの作製 ＊桐原聡秀(大阪大学) 72. 全固体二次電池のｼｽﾃﾑﾃﾞｻﾞｲﾝ手法に関する研究 ＊岸田航平，岩浅達哉，佐藤了平，岩田剛治(大阪大学) 73. リチウムイオン二次電池用電解銅箔の疲労特性に及ぼす添加剤の影響 ＊永山卓弥，荘司郁夫(群馬大学)，西貞三，呉元元(西工業㈱)
15:50	Coffee Break		
16:10 ～ 17:30	[A-6]　ナノ・マイクロマテリアル 座長：伊藤　健　（神奈川県産業技術センター） 26. Au・Ag系ナノポーラス粉末を接着層として用いるAu－Auの低温接合に関する研究 ＊三松隼太，水野潤，庄子習一，斎藤美紀子(早稲田大学)，梅津理恵(東北大学)，西川宏(大阪大学) 27. 銀ナノ粒子インクをめっき下地とした銅配線の密着性 ＊白髪　潤，冨士川　亘，村川　昭，斉藤　公恵，義原直，魚田　将史，藤野　理香(DIC㈱) 28. いがぐり状マイクロサイズAg粒子を用いたCu/Cu接合プロセスの検討 西川　宏，＊王　暁帆(大阪大学)，藤田　晶，鎌田信雄，齋藤六雄(化研テック㈱) 29. 無加圧接合可能な銀ナノペーストの開発と信頼性評価 ＊遠藤圭一，三好宏昌，栗田哲，永岡実奈美(DOWAエレクトロニクス㈱)，柴田義範，古川雅志，小林裕臣(トヨタ自動車㈱)	[B-6]　はんだ接合界面 座長：小山　真司（群馬大学） 56. 473KにおけるCuとSn-Ni合金の反応拡散による化合物の成長挙動 ＊梶原正憲，中山美紗子(東京工業大学) 57. Sn-Agはんだ・銅微細接合部のエレクトロマイグレーション現象に及ぼすはんだの化合物化の影響 ＊安藤宏樹，上西啓介，宮崎雄介(大阪大学)，作山誠樹，赤松俊也(富士通研究所) 58. Sn3Ag0.5CuはんだとW基板上Ni-Bめっきメタライズ界面に生成するSn-W構造 ＊依田智子，原田正英（㈱日立製作所），西川徹（日本オクラロ），小林竜也[1]，荘司郁夫（群馬大学）　[1]現所属は㈱東芝	[C-4]　マイクロ接合・新材料プロセス(2) 座長：前田　将克（大阪大学） 74. レーザ微細はんだ付けにおける温度制御の有効性 三浦栄朗，＊澤井康男(ﾐﾔﾁﾃｸﾉｽ㈱) 75. 個体イオン交換法によるレーザ加工用ガラスの開発 ＊野村孟嗣，松坂壮太，比田井洋史，森田昇，千葉明(千葉大学) 76. 短繊維強化樹脂材料の機械的特性に及ぼす繊維方向および温度の影響 ＊髙橋諒伍，荘司郁夫(群馬大学)，関 祐貴，丸山 敏(㈱山田製作所) 77. 双ロール法により作製した高Al含有Mg合金の時効硬化とミクロ組織 ＊秋山主,荘司郁夫,小山真司,西田進一,渡利久規(群馬大学),藤倉圭佑(群馬大学,現東工大)
17:30	表　彰　式　　（A会場）		
17:40	閉会の挨拶　　Mate2014組織委員会副委員長　齋藤 重正　　（A会場）		

※掲載内容は、当日変更される場合があります。

組織委員会

委 員 長　：　藤本公三　(大阪大学)

副委員長　：　齋藤重正　(富士電機(株))

委　　員　：

青柳昌宏	((独)産業技術総合研究所)	渥美幸一郎	(大阪大学)	荒井栄司	(大阪大学)
大西 寛	(三菱電機(株))	小勝俊亘	(日本電気(株))	越川孝範	(大阪電気通信大学)
小林紘二郎	((財)電子科学研究所)	佐藤武彦	(大阪大学)	佐藤了平	(大阪大学)
嶋田勇三	(ナミックス(株))	菅沼克昭	(大阪大学)	高橋康夫	(大阪大学)
竹本 正	(大阪大学)	田中敏宏	(大阪大学)	西田一人	(パナソニック(株))
貫井 孝	(大阪大学)	日置 進	(NPO E-TECH)	廣瀬明夫	(大阪大学)
二上範之	(シャープ(株))	益子原學	((株)ザイキューブ)	町田一道	(中部大学)
松村慶一	(ジー・エス・イー(株))	南二三吉	(大阪大学)	宮崎則幸	(京都大学)
森 郁夫	((株)東芝)	矢野 映	((株)富士通研究所)	横塚剛秀	((株)日立製作所)
吉田 隆	(富士電機(株))				

実行委員会

委 員 長　：　荘司郁夫　(群馬大学)

副委員長　：　上西啓介　(大阪大学)　　小梁川尚　((株)東芝)

委　　員　：

赤松俊也	((株)富士通研究所)	朝倉義裕	(神戸市立工業高等専門学校)	新井 進	(信州大学)
池田 徹	(鹿児島大学)	石塚直美	(日本電気(株))	出田吾朗	(三菱電機(株))
市村裕司	(富士電機(株))	一山靖友	(日鉄住金ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ(株))	伊藤元剛	((株)東ﾚﾘｻｰﾁｾﾝﾀｰ)
井上雅博	(群馬大学)	岩田剛治	(大阪大学)	于　強	(横浜国立大学)
海老原伸明	(NEC東芝ｽﾍﾟｰｽｼｽﾃﾑ(株))	大口達也	(日本ｱﾋﾞｵﾆｸｽ(株))	大熊秀雄	((有)ｴｲﾁ・ﾃｨｰ・ｵｰ)
大貫 仁	(茨城大学)	大村悦二	(大阪大学)	岡本 剛	(パナソニック(株))
小川倉一	(小川創造技術研究所)	小椋 智	(大阪大学)	折井靖光	(日本ｱｲ･ﾋﾞｰ･ｴﾑ(株))
加柴良裕	(三菱電機(株))	加藤力弥	(千住金属工業(株))	鎌田信雄	(化研テック(株))
苅谷義治	(芝浦工業大学)	管野敏之	((株)MORESCO)	久保雅男	(パナソニック(株))
栗原 孝	(新光電気工業(株))	河野英一	((株)河野ｴﾑｲｰ研究所)	小山真司	(群馬大学)
今野武志	((独)物質・材料研究機構)	阪元智朗	(オムロン(株))	作山誠樹	((株)富士通研究所)
佐名川佳治	(パナソニック(株))	佐野智一	(大阪大学)	三治真佐樹	((株)デンソー)
宍戸逸朗	(京ｾﾗSLCﾃｸﾉﾛｼﾞｰ(株))	柴崎正訓	((株)タムラ製作所)	澁谷忠弘	(横浜国立大学)
清水寿一	(住友金属鉱山(株))	角谷 透	((株)船井電機新応用技術研究所)	節原裕一	(大阪大学)
芹沢弘二	(千住金属工業(株))	高尾尚史	((株)豊田中央研究所)	高岡英清	((株)村田製作所)
高橋邦夫	(東京工業大学)	武井利泰	(日本精工(株))	津久井勤	(ﾘｻｰﾁﾗﾎﾞ・ﾂｸｲ)
冨岡泰造	((株)東芝)	富村壽夫	(熊本大学)	中村清智	(凸版印刷(株))
西浦正孝	(パナソニック(株))	西川 宏	(大阪大学)	浜野寿之	(エスペック(株))
久田隆史	(日本ｱｲ･ﾋﾞｰ･ｴﾑ(株))	弘田実保	((株)村田製作所)	福本信次	(大阪大学)
藤原伸一	((株)日立製作所)	前田将克	(大阪大学)	松坂壮太	(千葉大学)
松嶋道也	(大阪大学)	松林 良	(新電元工業(株))	圓尾弘樹	(ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ ﾌｧｸﾄﾘｰｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ(株))
水野 潤	(早稲田大学)	三谷 進	(ニホンハンダ(株))	宮澤 寛	(DOWAﾒﾀﾙﾃｯｸ(株))
森 貴裕	((株)ADEKA)	森 敏彦	(名古屋大学)	安田清和	(大阪大学)
山内 啓	(群馬工業高等専門学校)	山口敦史	(パナソニック(株))	山下志郎	((株)日立製作所)
山中公博	(中京大学)	山根常幸	((株)東ﾚﾘｻｰﾁｾﾝﾀｰ)	山部光治	((株)東芝)
渡邉 聡	(藤倉化成(株))	渡辺 潤	(長野沖電気(株))	渡邉裕彦	(富士電機(株))
渡辺裕之	(イビデン(株))				

会場アクセス

パシフィコ横浜　会議センター

＊みなとみらい線　みなとみらい駅より徒歩3分

＊JR線・市営地下鉄　桜木町駅より徒歩12分

＊横浜駅よりタクシー7分、シーバス（船）で10分

問合わせ先：Mate 2014 事務局

(TEL) 06-6878-5628，(FAX) 06-6879-7568

(E-mail) mate@sps-mste.jp，(URL) http://sps-mste.jp/mate2014/src/